

2026-2031年半导体企业创业板IPO上市工作咨询指导报告

报告简介

企业发展到一定阶段就会遇到资金制约问题，而资本市场作为企业的主要融资渠道之一具有融资效率高、规模大、限制条件少等众多优势。由于资本市场融资进限于创业板上市企业和首发创业板上市企业，企业的创业板上市问题就变得十分关键。

企业创业板上市有以下好处：

- 1、创业板上市时及日后均有机会筹集资金，以获得资本扩展业务;
- 2、扩大股东基础，使公司的股票在买卖时有较高的流通量;
- 3、向员工授予购股权作为奖励和承诺，增加员工的归属感;
- 4、提高公司(发行人)在市场上地位及知名度，赢取顾客信供应商的信赖;
- 5、增加公司的透明度，有助于银行以较有利条款批出信贷额度;
- 6、创业板上市发行人的披露要求较为严格，使公司的效率得以提高，藉以改善公司的监控、资讯管理及营运系统，公司运作更加规范。
- 7、通过创业板上市融资筹集资本，使企业快速健康发展，做大做强，成为长寿百年企业。

我国企业创业板上市可以考虑在深圳企业板、美国纳斯达克等多个证券交易市场，每个市场的创业板上市条件与实施过程均有所不同。

在这里我们就国内半导体行业企业在国内创业板上市常见问题和具体操作给出建议，除此之外针对企业存在的特定问题给出相应的解答方案。这对于有意创业板上市的企业具有极好的参考价值和指导意义。

报告目录

第一章 半导体行业企业创业板上市利弊与创业板上市环境分析

第一节 创业板上市之益处

第二节 创业板上市之弊端

第三节 半导体行业企业创业板上市与行业发展

第四节 半导体行业企业创业板上市环境

第五节 证监会对于半导体行业企业创业板上市的监管政策

第二章 2021-2026年国内创业板上市形势分析

第一节 发行市盈率依然较高

第二节 发行筹资规模有较大提高

第三节 发行审核节奏大大加快

第四节 发行审核通过率分析

第五节 制度体系建设日臻完善

第三章 半导体行业企业国内创业板上市基本条件

第一节 首发创业板上市法定条件

第二节 证监会审核关注重点

第三节 半导体行业企业创业板上市可行性分析

第四节 半导体行业企业当前需解决、改进或完善的问题

第四章 半导体行业企业创业板上市方案

第一节 半导体行业企业创业板上市流程

第二节 半导体行业企业改制思路

第三节 半导体行业企业发行定价与筹资金额测算

第四节 企业内部创业板上市团队的配置方案

第五节 创业板上市中介机构的聘请

第六节 创业板上市项目组管理模式与分工合作

第五章 创业板上市中介机构选择与工作协调

第一节 券商的选择与工作模式

一、券商的选择与费用指导

二、券商工作内容与定位

三、券商的工作模式

四、半导体行业企业创业板上市券商重点关注的问题

第二节 会计师事务所的选择与工作模式

一、会计师事务所的选择与费用指导

二、会计师事务所工作内容与定位

三、会计师事务所的工作模式

四、半导体行业企业创业板上市会计师事务所重点关注的问题

第三节 资产评估事务所的选择与工作模式

一、资产评估事务所的选择与费用指导

二、资产评估事务所工作内容与定位

三、资产评估事务所的工作模式

四、半导体行业企业创业板上市资产评估事务所重点关注的问题

第四节 律师事务所的选择与工作模式

一、律师事务所的选择与费用指导

二、律师事务所工作内容与定位

三、律师事务所的工作模式

四、半导体行业企业创业板上市律师事务所重点关注的问题

第五节 咨询公司的选择与工作模式

一、咨询公司的选择与费用指导

二、咨询公司工作内容与定位

三、咨询公司的模式

四、半导体行业企业创业板上市咨询公司重点关注的问题

第六章 半导体行业企业创业板上市重点问题的处理建议

第一节 改制问题

一、企业改制手续处理建议

二、股权纠纷问题处理建议

三、企业改制与管理层安排建议

第二节 财务审计问题

一、大股东审计问题处理建议

二、历史财务审计问题处理建议

三、审计报告常见错误分析

四、关联交易财务处理问题建议

第三节 法律问题

一、重大合同处理

二、股权转让确认

三、商标产权争议

四、对外合作协议

五、股东大会决议

第四节 募集资金投向问题

一、项目可行性研究报告撰写

二、募集资金规模

三、募投项目选择

四、新建扩建问题

五、立项申报流程

第五节 社保环评等问题

一、社保问题处理

二、历史环评报告与环保局批文

第六节 制度健全问题

一、管理内控制度完善

二、创业板上市公司配套制度设立

三、人事安排与股权激励

四、财务制度健全

第七章 招股说明书中影响半导体行业企业创业板上市的重点问题处理建议

第一节 公司基本情况章节常见问题

一、企业改制重组流程完备性

二、企业股本变化问题

三、企业对外投资问题

四、员工社保与员工持股问题处理

第二节 业务与技术章节常见问题

一、业务描述与定位

二、各业务市场容量

三、企业竞争对手分析

四、上下游厂商以及经营授权问题

五、技术研发与质量控制问题处理

第三节 同业竞争与关联交易章节问题

一、同业竞争问题处理

二、关联交易问题处理

三、避免同业竞争与关联交易处理制度设计

四、现有同业竞争与关联交易的处理措施

第四节 募投项目常见问题

一、项目投产前后指标变化解释

二、项目投资收益指标设计

三、项目产品市场容量测算

四、项目生产工艺与核心技术处理

五、项目可行性与合理性分析

六、项目备案流程

第五节 财务报告问题

一、会计制度调整

二、财务状况变动问题

三、盈利、偿债等指标处理

四、重大财务收支问题的处理

五、各项财务数据的确认

第六节 公司治理问题

第七节 股利分配问题

第八节 业务发展目标设计

第八章 影响创业板上市进度的重点环节处理建议

第一节 企业工商档案问题

第二节 募投项目问题

第三节 审计问题

第四节 环评批文问题

第五节 股权处理问题

第六节 重大法律纠纷

第九章 半导体行业企业创业板上市成功率影响因素

第一节 2021-2026年半导体行业企业创业板上市成功率统计

第二节 2021-2026年半导体行业企业创业板上市失败案例主要问题分布

第三节 证监会对半导体行业企业创业板上市最为关注的问题

第四节 半导体行业企业创业板上市成功案例解读

第五节 半导体行业企业创业板上市时机选择

第十章 2026-2031年半导体行业企业创业板上市前景预测

第一节 2026-2031年半导体行业企业创业板上市趋势分析

第二节 2026-2031年半导体行业企业创业板上市环境预测

第三节 2026-2031年证监会对半导体行业企业创业板上市的政策走向

第四节 2026-2031年半导体行业企业创业板上市与行业发展预期

第五节 半导体行业拟在2026-2031年创业板上市的企业应采取的基本措施

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费) Email : kf@51baogao.cn

报告编号：125606

本文地址：<https://www.51baogao.cn/sc/20190628/125606.shtml>

在线订购：[点击这里](#)